

▶ 高性能 FPC

HIGH PERFORMANCE FPC

I 超極薄 FPC (要相談)

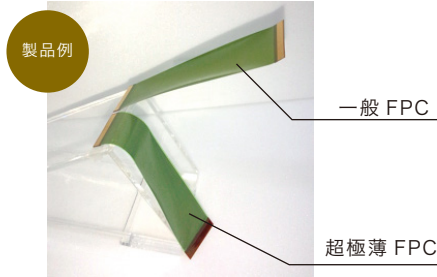
特長

- ・ 最小基板厚 $17\mu\text{m}$ ⇒ 厚さ約 60% 薄型化 (当社比)
- ・ 柔軟性向上 ⇒ 低反発性
- ・ 省スペース化・軽量化 ⇒ 重量約 30% 軽量化 (当社比)

(注) 重量は回路形状により変化します

〈用途例〉

次世代ウェアラブル医療機器
スポーツ科学用途のウェアラブルワイヤレス電子機器
その他、軽量・省スペースの要求される電子機器

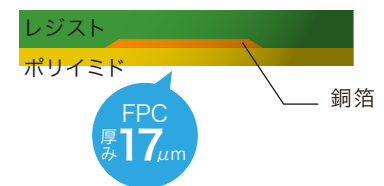


仕様・構造

■ 薄型片面 FPC (従来品)



■ 超極薄仕様片面 FPC



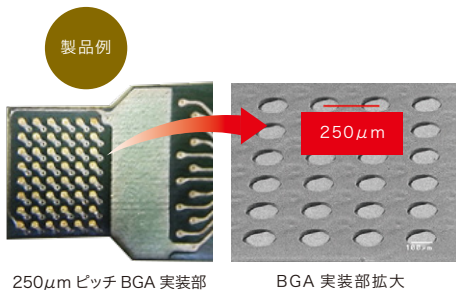
I 高密度多層 FPC

特長

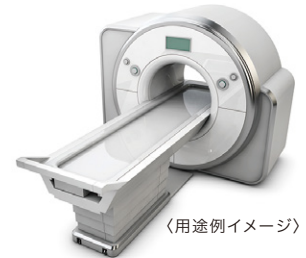
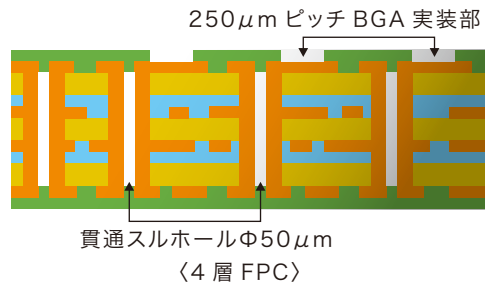
- ・ $250\mu\text{m}$ ピッチ BGA 対応
- ・ 貫通 TH $\phi 50\mu\text{m}$
- ・ 最小ランド $\phi 100\mu\text{m}$
- ・ インピーダンス対応

〈用途例〉

各種センサー実装用
医療機器
スマートフォン等の
携帯電子機器



仕様・構造

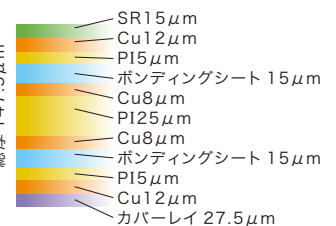
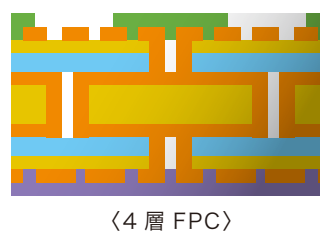
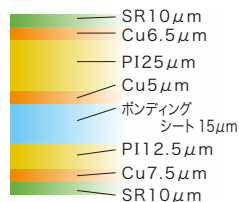
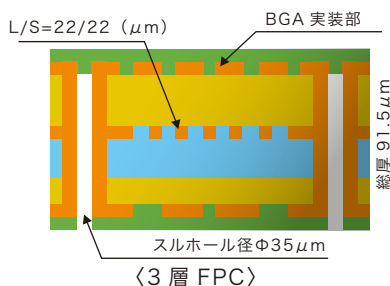


I 極薄多層 FPC (要相談)

特長

- ・ 3層 FPC 総厚: $100\mu\text{m}$ 以下
- ・ 貫通 TH $\phi 35\mu\text{m}$
- ・ 4層 FPC 総厚: $150\mu\text{m}$ 以下
- ・ ランド $\phi 100\mu\text{m}$
- ・ $\text{min}L/S = 22\mu\text{m}/22\mu\text{m}$

仕様・構造



〈用途例〉 医療機器 スマートフォン等の携帯電子機器